

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 3 部門第 4 区分
 【発行日】平成 24 年 5 月 24 日 (2012.5.24)

【公表番号】特表 2008-542550 (P2008-542550A)
 【公表日】平成 20 年 11 月 27 日 (2008.11.27)
 【年通号数】公開・登録公報 2008-047
 【出願番号】特願 2008-515230 (P2008-515230)
 【国際特許分類】

C 2 3 C 24/10 (2006.01)

【F I】

C 2 3 C 24/10 B

【誤訳訂正書】

【提出日】平成 24 年 3 月 30 日 (2012.3.30)

【誤訳訂正 1】

【訂正対象書類名】特許請求の範囲

【訂正対象項目名】全文

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

レーザ装置 (6) と、指向性を有するレーザビームによる原料処理のための処理槽 (10) とを備え、

前記処理槽 (10) は、

ビーム (7) を処理槽 (10) の内部に結び付ける光学素子で、その処理槽の内側に表面 (9a) を有する光学素子 (9) と、

前記光学素子 (9) 周囲の壁部 (12) と、

前記光学素子 (9) の一方の側に設けられ、第 1 ガス (18) が前記光学素子の表面 (9a) を実質的に接線方向に撫でるように流れ込むように策定された第 1 注入口 (16) と、

第 2 ガス (25) が前記第 1 ガス (18) の流れと実質的に同一方向で前記表面 (9a) から距離を隔てて流れ込むように策定されて設けられた第 2 注入口 (23) とを有し、

前記第 1 注入口 (16) および第 2 注入口 (23) の一方または両方が、スリット形状を有し、

前記第 1 注入口 (16) または前記第 2 注入口 (23) は、前記光学素子 (9) の幅より広いことを特徴とするレーザ焼結装置。

【請求項 2】

請求項 1 に記載のレーザ焼結装置において、前記注入口 (16, 23) は、一方が他方の下方に配置されていることを特徴とするレーザ焼結装置。

【請求項 3】

請求項 1 または請求項 2 に記載のレーザ焼結装置において、第 1 ガス (18) と第 2 ガス (25) とは実質的に薄層流であることを特徴とするレーザ焼結装置。

【請求項 4】

請求項 1 から請求項 3 までのうちの一つに記載のレーザ焼結装置において、

処理槽 (10) の壁部 (12) は、第 2 注入口 (23) を介して流れ込むガスが前記表面 (9a) から離れた方向に推進力が得られるように策定されて設けられる構造部 (12b) を有することを特徴とするレーザ焼結装置。

【請求項 5】

請求項 4 に記載のレーザ焼結装置において、前記構造部 (12b) は、実質的に中空円

筒の形状、または、部分的な中空円筒の形状を有していることを特徴とするレーザー焼結装置。

【請求項 6】

請求項 4 または請求項 5 に記載のレーザー焼結装置において、前記第 2 注入口 (2 3) は、前記第 1 注入口 (1 6) の下方に配置されていることを特徴とするレーザー焼結装置。

【請求項 7】

指向性を有するレーザービームによる原料処理のためのレーザー焼結方法において、

電磁放射の指向性ビーム (7) を、処理槽 (1 0) の内側に窓面 (9 a) を有する接続窓 (9) を介して処理槽の内部に方向付けするステップと、

前記窓面 (9 a) を実質的に接線方向に撫でるように一方から流れ込むように注入される第 1 ガス (1 8) を前記処理槽に第 1 注入口 (1 6) を通して供給するステップと、

前記第 1 ガス (1 8) の流れと実質的に同一方向で前記窓面 (9 a) から距離を隔てて流れ込むように注入される第 2 ガス (2 5) を前記処理槽に第 2 注入口 (2 3) を通して供給するステップとを有し、

前記第 1 注入口 (1 6) および第 2 注入口 (2 3) の一方または両方が、スリット形状を有することを特徴とするレーザー焼結方法。

【請求項 8】

請求項 7 に記載のレーザー焼結方法において、請求項 1 から請求項 6 までのうちの一つに記載のレーザー焼結装置を用いることを特徴とするレーザー焼結方法。

【誤訳訂正 2】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 0

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 1 0】

本発明によるレーザー焼結装置は、その目的を達成するため、レーザー装置 (6) と、指向性を有するレーザービームによる原料処理のための処理槽 (1 0) とを備え、前記処理槽 (1 0) は、ビーム (7) を処理槽 (1 0) の内部に結び付ける光学素子で、その処理槽の内側に表面 (9 a) を有する光学素子 (9)と、前記光学素子 (9)周囲の壁部 (1 2) と、前記光学素子 (9)の一方の側に設けられ、第 1 ガス (1 8) が前記光学素子の表面 (9 a)を実質的に接線方向に撫でるように流れ込むように策定された第 1 注入口 (1 6) と、第 2 ガス (2 5) が前記第 1 ガス (1 8) の流れと実質的に同一方向で前記表面 (9 a)から距離を隔てて流れ込むように策定されて設けられた第 2 注入口 (2 3) とを有し、

前記第 1 注入口 (1 6) および第 2 注入口 (2 3) の一方または両方が、スリット形状を有し、前記第 1 注入口 (1 6) または前記第 2 注入口 (2 3) は、前記光学素子 (9) の幅より広いことを特徴とする。

【誤訳訂正 3】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0 0 1 1

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0 0 1 1】

また、本発明によるレーザー焼結方法は、指向性を有するレーザービームによる原料処理のためのレーザー焼結方法において、電磁放射の指向性ビーム (7) を、処理槽 (1 0) の内側に窓面 (9 a) を有する接続窓 (9) を介して処理槽の内部に方向付けするステップと、前記窓面 (9 a) を実質的に接線方向に撫でるように一方から流れ込むように注入される第 1 ガス (1 8) を前記処理槽に第 1 注入口 (1 6) を通して供給するステップと、前記第 1 ガス (1 8) の流れと実質的に同一方向で前記窓面 (9 a) から距離を隔てて流れ込むように注入される第 2 ガス (2 5) を前記処理槽に第 2 注入口 (2 3) を通して供給

するステップとを有し、前記第 1 注入口 (1 6) および第 2 注入口 (2 3) の一方または両方が、スリット形状を有することを特徴とする。